证券代码：601231　　证券简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司
2026 年第三季度投资人线上说明会活动记录

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
时间	2026 年 10 月 28 日
地点	线上会议（进门财经网络研讨会）
上市公司参会人员	魏镇炎（总经理）、林孟辉（副总经理）、魏振隆（副总经理）、史金鹏（董事会秘书）、吴新宇（财务长）
参会机构名称	东北证券、国海富兰克林、花旗银行、华泰证券、麦格理资本、摩根大通证券、摩根士丹利、全知投资、瑞银证券、山西证券、西部证券、新光人寿、兴业证券、野村国际、永丰证券、中信证券
嘉宾简报及投资者提问	**一、公司2026年第三季度经营业绩情况（财务长吴新宇先生）** **【经营情况概述】** 2026年前三季度营业收入为468.8亿元，较去年同期同比增长7.4%。2026年第三季度营业收入为195.4亿元，较第二季度环比增长39.7%，较去年同期同比增长19.0%，符合前期业绩指引。营业收入同比增长主要得益于AI智能卡出货量成长、消费电子新产品量产贡献，以及因供应紧缺造成的重要物料涨价而带来的产品售价提升，此外人民币兑美元汇率上升抵减了部分增长。 第三季度营业利润率为4.1%，较去年同期的4.4%，同比减少0.3个百分点。第三季归母净利润为7.1亿元，归母净利润率为3.7%，较去年同期的3.8%，同比减少0.1个百分点。扣非后归母净利润为6.6亿元。 前三季度归属于上市公司股东的净利润率为3.3%，较去年同期的2.9%，同比增长0.4个百分点。2026年前三季度每股收益为人民币0.65元/股，2025年前三季度每股收益为人民币0.58

	元/股，同比增长12.07%。EBITDA、EPS同比增长；受净资产变动原因ROA、ROE基本持平。 **【营业收入分析】** 第三季度实现营业收入为195.4亿元，较去年同期的164.3亿元，同比增长19.0%，相较于第二季度139.9亿元，环比增长39.7%。 2026年前三季度营业收入为468.8亿元，综合材料售价、新产品量产及AI智能卡的成长，扣除人民币汇率的负面影响，较去年同期同比增长7.4%。 因受市场需求及客户总体需求影响，各类产品营收同比呈现不同的增降幅度。 其中： （1）通讯类产品实现营收23.8亿元，同比减少50.7%，主因主控芯片采购价格下降、行业竞争及客户产品发布节奏安排导致收入下降。（2）消费电子类产品实现营收93.8亿元，同比增长31.2%；主系穿戴产品及新客户业务量增长所致。（3）工业类产品实现营收23.4亿元，同比增长25.9%；主系本期现有客户业务订单增长所致。（4）云端及存储类产品实现营收41.8亿元，同比增长211.2%；主系得益于AI智能卡出货量成长，及受DRAM材料价格因紧缺大幅上涨影响所带来的产品销售价格同步增长。（5）汽车电子类产品实现营收9.2亿元，同比减少1.2%，主因合并报表范围变化及业务量减少所致，在去年第三季将间接持有的控股子公司环强电子出售。（6）医疗类产品份额较小，实现营收1.0亿元，同比增长26.1%。 **【营业毛利及毛利率】** 第三季度实现营业毛利17.3亿元，同比增长11.6%，相较于第二季度环比增长50.6%。 第三季度营业毛利率为8.9%，受到原物料价格上涨所带来的摊薄影响以及产品组合的变化，较去年同期的9.5%同比减少0.6个百分点,相较于第二季的8.2%，环比增长0.7个百分点。 其中： 云端及存储类产品毛利同比增加39.4%，毛利率同比减少11.1个百分点，主系当期DRAM材料成本大幅上涨对利润率百分比形成摊薄影响，另外产品组合结构的变化，也给当期毛利率带来压力。 通讯类产品因行业竞争及产品客户发布节奏安排所致营收下滑，毛利同比减少23.2%，得益于部分一次性因素影响，毛利率同比增长4.5个百分点。 消费电子类产品受穿戴产品业务量增长、产品组合变动及汇率变动的多个因素影响，导致毛利同比增长32.1%，毛利率同比增长0.1百分点，当期采购材料价格大幅上涨，摊薄了毛利率。

	汽车电子类产品毛利同比减少46.4%，毛利率同比减少3.5个百分点，主系公司合并报表范围变化，在去年第三季将间接持有的控股子公司环强电子出售所带来的毛利率的减少。 工业类产品毛利同比减少5.2%，毛利率同比减少3.8百分点。 【现金流量】 公司2026年前三季度现金流量为净流出28.8亿，其中： 经营活动产生的现金流2026年前三季度为净流出人民币1.2亿，主系因材料供应紧张、提前备料且材料涨价。营收增长集中于第三季度后半季，新增销售对应的应收账款尚未到期回收，导致销售增长与现金回款存在时间性差异。 第三季度经营活动现金流较上半年明显改善，相比上半年净流出人民币4.7亿，至三季度末，净流出规模收窄至人民币1.2亿，主要得益于前季度末销售规模增长于本季度内回款，其中销售商品、提供劳务收到的现金增幅高于采购付款及各项经营性支出的增长幅度，当季经营现金净流入3.5亿。 投资活动产生的现金流2026年前三季度为净流出26.8亿，较去年同期流出增加人民币14.5亿，主系本期子公司新购土地、收购境内公司股权及外汇避险操作产生的已实现收益较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流2026年前三季度为净流出0.7亿，较去年同期流出减少人民币5.2亿，主系本期短期借款增幅高于向股东发放现金股利增幅所致。 **【营运资本周转及主要财务指标分析】** 因重要材料供货持续紧张，公司提前备料，现金周转天数较去年同期增加3天，至44天，整体仍处于健康水平。2026年第三季度末公司总资产、净资产有所增长，有息负债因可转换债券转股及赎回原因，较去年年底减少20.7%，资产负债率受公司提前备料等原因，应付款上升，本期较去年底增长1.7个百分点。2026年前三季度总资产收益率3.5%，加权平均净资产收益率为6.8%，每股收益为0.65元/股 **【经营目标】** 公司2026年第三季度在营业收入符合预期、营业利润率优于预期。 预计第四季度营收同比增长15%-20%，主要受关键物料价格上涨传导及部分业务出货量增加的共同推动。预计第四季度营业利润率较去年同期下降约1.8个百分点，主要由于去年同期土地处置收益带来的较高比较基数，以及物料成本占比上升对营业利润率的阶段性影响。 尽管面临上述挑战，公司业务发展仍呈现一些积极信号。其中，海外子公司法国飞旭受

	益于欧洲本地化服务需求持续增长，业务规模和运营效率显著提升，带动毛利及营业利润同比大幅改善，并有望将良好的增长势头延续至2027年。同时，越南生产基地随着产能利用率提升、出货量增长及生产效率持续改善，对整体盈利能力的贡献不断增强，为公司未来发展提供了新的增长动力。 未来，公司将继续聚焦光通信业务拓展、全球化运营能力建设及运营效率提升，通过优化产品组合、加强区域化服务布局及推动新业务成长，为股东创造长期可持续价值。 **【Q&A环节】** **【问题】请公司介绍下目前光通信业务的相关进展** **【回答】**按照公司的产能规划，今年在成都和越南投资按期推动，目前成都扩产在安装调试，预计11月具备120K/M光引擎产能。越南计划建成从光引擎到光模块完整的产能，10月开始100K/M的自动化组装线正在安装调试，后端的测试设备也将陆续到位，预计Q4越南产能可以完成建设。后续公司会根据客户订单情况规划扩产计划，目前还在和客户积极沟通。 关于ELSFP，公司在9月深圳光博会上展示了样本的Live Demo，受到了不错的关注，10月美国OCP展会公司也参加了，借这个机会接触了不少北美客户，包括D-FAU也在设计方案上取得了一定的进展并与客户进行交流。从目前的进展来看，客户反馈比较积极，公司在成都已开始投建千级洁净室，预计在今年年底就能够建成。这个千级洁净室一方面会服务客户对洁净等级更高的OE制造要求，同时也会服务ELSFP在成都的率先验证和量产，进而后续公司会根据客户的需求情况，在越南投资ELSFP的产能。 鉴于客户对公司ELSFP的反馈积极，公司优先考虑在成都形成NPI及一定的量产能力，有望在27Q1完成建设，不仅服务于海外市场，国内市场也会有机会。 公司光通信业务尚处于发展阶段，目前相关业务收入占公司整体营业收入不足1%，比例较低。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 **【问题】请公司介绍下AI加速卡业务的情况及垂直领域业务延伸的展望** **【回答】**关于AI加速卡公司在产能上持续投资，从去年的2条产线到今年的4条产线，规划明年投资到总计7条产线，相应每年的收入也会大幅成长。而在AI服务器主板卡层面，受限于目前公司产能的扩张速度，还需要一定时间，主要原因在于这部分业务在中国台湾生产，而中国台湾的厂房资源相对紧缺，公司会在2027年积极扩张产能以期在2028年取得主板卡的业务。

	【问题】预计明年是公司大客户在硬件端的创新大年，预估明年SiP业务的料号情况如何？眼镜的大客户那边SiP的料号如何展望？ **【回答】**公司看到近年来AI模型能力提升很快，北美CSP客户大幅增加AI基础设施建设的基础上，几个主要的头部客户也在端侧硬件上有进一步的投入，体现在智能终端。今年已经可以看到一些新的智能终端产品，这些头部客户基本都是公司积极合作的伙伴，包括AI个人助理产品，公司也供应了SiP模组。 在更多的智能穿戴、智能家居等板块，也看到了更多的机会。目前公司在SiP模组的新产品应用的开发上是比较饱和的，同时目前部分智能终端产品尚待观察市场的反映，预计在明年下半年后能够更清晰的观察到市场的需求和营收的展望。 **【问题】公司D-FAU有哪些潜在客户，具体进展情况如何？** **【回答】**光创联在光耦合和光路设计方面还是有很强的技术能力，在D-FAU的设计上有一些创新的想法，目前一系列的专利申请已在推动中，预计在耦合效率和良率上会有创新的作用。D-FAU的样品预计年内可以推出，在进行内部测试后会与客户进行积极沟通。 公司光通信业务尚处于发展阶段，目前相关业务收入占公司整体营业收入不足1%，比例较低。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 **【问题】**公司所布局的创新业务上，目前有什么投资计划？ **【回答】**公司创新业务布局包括算力板卡、光通信和服务器供电，公司计划围绕光通信和服务器供电业务的供应链寻找投资机会，以增强公司产品能力，未来有实际投资落地会依据法律法规要求及时履行信息披露义务。 **【问题】**公司光通信业务是否受到FCC的影响？ **【回答】**目前FCC尚无正式落地规则，公司持续保持关注，并做好积极准备应对。 **【问题】**产业信息显示中国台湾的一些厂商正在大力推进FAU的产业落地，公司D-FAU的竞争优势如何体现？ **【回答】**目前公司D-FAU方面的创新方案还在进行专利申请，当下D-FAU的痛点包括了FAU的加工精度、耦合效率，公司会在这些方面上加强研发，在产品性能、价格、制造服务能力等方面形成自身的竞争力，进一步与集团母公司形成紧密的上下游合作关系，取得赋能，构建差异化的竞争优势。 **【问题】**除现有客户外，其他北美眼镜客户SiP模组导入进展如何？

	【回答】公司智能眼镜SiP业务，与北美多个客户有深度合作，从去年开始先从功能性SiP(Wi-Fi、PMIC)开始导入，今年开始主板模组也导入量产，在线路设计、结构微小化工艺到量产制造和质量控制上都取得了突破。 **【问题】**公司Q3的营业利润率高于预期，Q4是否有机会超过目前经营目标？ **【回答】**公司第三季度存在一些因为材料成本差异所形成的客户补偿，对营业利润有帮助。从今年Q3和Q4来看，包括DRAM和IC在内的物料涨价较多，对公司的营业利润造成摊薄影响，此外人民币兑美元汇率升值也影响了营业利润率。针对这些情况公司希望通过更积极布局创新业务丰富产品组合，提升盈利水平；同时，公司也在关注营运成本，包括各个据点的制造成本的改善，提高生产效率，并审视期间费用和营运资金。 前述物料涨价的情况，还会造成阶段性占用公司更多营运资金，公司也在和客户积极讨论业务模式的改善，包括高价值的材料由客户来供应，相应减少公司的资金占用。 **【问题】**ASE在此前的法说会上提到未来会给出CPO的指引，从公司的角度来看目前业务的能见度如何？ **【回答】**目前公司光通信尚处于布局和发展阶段，在产生阶段性的成果后会依据法律法规的要求在定期报告中进行披露。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 28 日